

COMSOL CONFERENCE

2026

11/06(五) 北科大集思會議中心

公協會會員免費

COMSOL 多物理量 AI + Digital Twin 技術年會

探索多物理模擬×人工智慧×數位雙生

本年會聚焦COMSOL多物理量模擬,結合AI建模與智慧分析,加速工程模擬、參數探索與數位雙生應用。

詳情請看



活動官網

VIP免費報名連結



2026 / 11 / 06 (五)
08:30 – 16:30



北科大集思會議中心 3F
台北市大安區忠孝東路三段 1 號
億光大樓 3 樓 (197 號旁)

年會亮點



掌握技術前沿

掌握 COMSOL Multiphysics®、AI 輔助建模、GPU 加速與數位分身的發展趨勢。



產業實務分享

從企業研發案例了解模擬技術如何應用於產品設計、製程分析與工程最佳化。



跨領域交流

與企業研發團隊、大學教授及工程專家面對面交流,拓展技術合作機會。

COMSOL 年會講師陣容

匯聚產學專家・分享前瞻知識與實務經驗



簡榮富

皮托科技股份有限公司
執行長



崔春山

皮托科技股份有限公司
CAE 技術副總



劉國安

台灣積體電路製造股份有限公司
TCADD 技術副理



劉建豪

國立臺灣大學
機械工程學系 副教授



洪銘聰

力致科技股份有限公司
導熱元件研發處 處長



段龍輝

緯創資通股份有限公司
人工智能領域專家部 處長



鄭皓隆

台達電子股份有限公司
磁性元件事業部
資深工程師



王文弘

迪芬尼聲學科技股份有限公司
台中研發部 資深經理



鍾震桂

國立成功大學
機械工程學系 特聘教授



鄭凱文

台灣積體電路製造股份有限公司
先進技術管理中心 博士



楊棟焜

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 副總



林谷昇

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 副理



邱健彰

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 博士



楊政勳

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 工程師



張軒嘉

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 工程師



黃君富

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 副理



陳建翔

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 工程師

COMSOL CONFERENCE 2026

11/06(五) 北科大集思會議中心



活動議程 A

2026 / 11 / 06 (五) 08:30 – 16:30

立即報名

時間	主題	講者
08:30–09:00	報到 Check-in	—
09:00–09:10	開場致詞	皮托科技股份有限公司 簡榮富 執行長
09:10–09:40	COMSOL 2027 與未來 AI 模擬趨勢發展	皮托科技股份有限公司 崔春山 CAE 技術副總
09:40–10:10	COMSOL 多物理在半導體的應用	台灣積體電路製造股份有限公司 研究發展 TCAD 處 劉國安 技術副理
10:10–10:30	中場休息	—
10:30–11:00	超靈敏三通道異質接面電晶體用於生醫感測	國立臺灣大學 機械工程學系 劉建豪 副教授
11:00–11:30	次世代高功率晶片先進熱管理：相變傳熱元件模擬與應用	力致科技股份有限公司 導熱元件研發處 洪銘聰 處長
11:30–12:00	星辰大海的 COMSOL、浩瀚無垠的 AI 關鍵模擬技術	緯創資通股份有限公司 人工智能領域專家部 段龍輝 處長
12:00–13:30	中午休息	—
13:30–14:00	PC 電源平面變壓器設計分享	台達電子工業股份有限公司 磁性元件事業部 鄭皓蓬 資深工程師
14:00–14:30	探討如何利用揚聲器模擬設計的方法做量產性預測	迪芬尼聲學科技股份有限公司 台中研發部 王文弘 資深經理
14:30–15:00	中場休息	—
15:00–15:30	COMSOL Multiphysics 模擬在感測器開發的應用	國立成功大學 機械工程學系 鍾震桂 特聘教授
15:30–16:00	COMSOL 於蝕刻機台之電漿 + 流場可視化分析與優化	台灣積體電路製造股份有限公司 先進技術管理中心 鄭凱文 博士
16:00–16:30	Q&A 討論 / 抽獎 / 賦歸	—